目錄

| | 頁次 |
|---------------------------------|----|
| 中文摘要 | I |
| 英文摘要 | П |
| 目錄 | Ш |
| 表目錄 | V |
| 圖目錄 | VI |
| 第一章 序論 | 1 |
| 第二章 實驗 | 4 |
| 2.1 試劑及其來源 | 4 |
| 2.2 分析儀器 | 4 |
| 2.3 產物之合成 | 5 |
| 2.3.1 利用CTAC做為晶面成長控制劑進行Cu-Ag置換反 | 應合 |
| 成奈米带狀銀 | 5 |
| 2.3.2 改變靜置時間觀察帶狀產物的改變 | 6 |
| 2.3.3 利用不同型態的碳膜進行反應,觀察帶狀產物 | 6 |
| 2.3.4 銅的影響 | 6 |
| 2.3.5 温度的影響 | 6 |
| 第三章 實驗結果與討論 | 7 |

| 3.1 改變靜置時間觀察帶狀產物的改變 | 7 |
|-------------------------------------|----|
| 3.1.1 利用 SEM 觀察不同靜置時間的產物型態 | 7 |
| 3.2 利用不同型態的碳膜進行反應,觀察帶狀產物 | 9 |
| 3.2.1 利用 SEM 觀察不同型態探膜的產物形態 | 9 |
| 3.3 銅的影響 | 11 |
| 3.3.1 利用 SEM 觀察銅網前處理過後的產物形態 | 11 |
| 3.4 温度的影響 | 13 |
| 3.4.1 利用 SEM 觀察感便反應溫度過後的產物型態 | 13 |
| 3.5 利用 TEM、ED、HRTEM與XRD對奈米銀帶作細部結構分析 | 14 |
| 第四章 反應機制與變因討論 | 19 |
| 第五章 結論 | 22 |
| 參考文獻 | 23 |

表目錄

| | 頁次 |
|----------------------|----|
| 表一 A 系列樣品之製備條件 | 26 |
| 表二 B 系列與 C 系列樣品之製備條件 | 26 |
| 表三 D系列與E系列樣品之製備條件 | 26 |



| 圖一 | (樣品A1)溶液靜置5 min後進行反應 (a)碳膜上的生成物之 |
|----|------------------------------------|
| | SEM影像圖 (b)圖(a)之能量分散光譜(EDS)27 |
| 圖二 | (樣品A2)靜置10 min反應後的生成物之SEM影像圖 (a)碳膜 |
| | 上 (b)碳膜與銅網之間28 |
| 圖二 | (樣品A3)溶液靜置15 min反應後碳膜上的生成物之SEM影 |
| | 像圖 (a)低倍率SEM影像圖 (b)高倍率SEM影像圖29 |
| 圖四 | (樣品B1)利用無洞碳膜進行反應,銅網上的生成物之SEM |
| | 影像圖 (a)低倍率SEM影像圖 (b)高倍率SEM影像圖30 |
| 圖五 | 溶液靜置15 min有洞碳膜的反應生成物之SEM影像圖(a)(樣 |
| | 品B2)有許多奈米銀帶 (b)(樣品B3)只有右邊部分有奈米銀 |
| | 帶,左上方沒有 (c)(樣品B4)沒有奈米銀帶31 |
| 圖六 | (a)最佳的碳膜形態 (b)最佳形態碳膜反應後的生成物32 |
| 圖七 | (樣品C1)無碳膜銅網在最佳條件下進行反應之SEM影像圖 |
| | (a)低倍率SEM影像圖 (b)高倍率SEM影像圖33 |
| 圖八 | (樣品C2)銅片在最佳條件下反應之SEM影像圖 (a)低倍率 |
| | SEM影像圖 (b)高倍率SEM影像圖34 |
| 圖力 | (樣品D1) 銅網473 K執處理24小時,以最佳條件進行反應 |

| | 的SEM影像圖 (a)與(b)皆為碳膜上的反應生成物35 |
|-----|--------------------------------------|
| 圖十 | 銅網473 K熱處理24小時的SEM影像圖 (a)低倍率SEM影像 |
| | 圖 (b)高倍率SEM影像圖36 |
| 圖十一 | (樣品D1) 銅網473 K熱處理24小時,以最佳條件進行反應 |
| | 的SEM影像圖 (a)與(b)皆為銅網上的反應生成物。(C)為圖 |
| | (b)之能量分散光譜圖(EDS)37 |
| 圖十二 | (樣品E1)銅網在298 K進行反應的SEM影像圖(a)碳膜上 |
| | (b)銅網上38 |
| 圖十三 | (A)奈米銀帶TEM影像圖 (B)奈米銀帶示意圖 (C)將圖(A) |
| | 箭頭所指部位放大,基座無傾斜(x=0,y=0);(D)基座沿 |
| | 著y軸傾斜19°(x=0,y=19);(E)基座沿著x軸傾斜19°(x |
| | =19,y=0)。圖(C)到(E)可以清楚看見箭頭所指部分有不 |
| | 同的寬度,從圖(D)可知奈米銀帶厚度約為3.6 nm,其寬度 |
| | 約在11 nm到23 nm之間,其寬度與厚度比(w/t)約為3到6。39 |
| 圖十四 | (a)奈米銀帶的低倍率 TEM 影像圖 (b)對圖(a)中的奈米銀 |
| | 带進行全光束電子繞射所得的ED 圖;右半邊為利用銀fcc |
| | XRD 數據轉換所得電子繞射圖 (c)為對圖(a)中的奈米銀帶 |
| | 進行全光束電子繞射所得的 ED 圖;右半邊為利用銀hcp |
| | XRD 數據轉換所得雷子繞射圖,其中較細的圓圈表示其強 |

| | 度較強。其中較粗的圓圈表示其強度較 | 10 |
|-----|---|------------|
| 圖十五 | (a)奈米銀帶 TEM 影像圖 (b)對圖(a)中的單一奈米銀帶進 | |
| | 行電子繞射(圈選部份)所得的 ED 圖 (c)奈米銀帶HRTEM | |
| | 影像圖,其層間距為0.25 nm,與銀hcp結構中的(10-10)面 | |
| | 層間距0.25 nm相同。 | 1 1 |
| 圖十六 | (a)奈米銀帶成核點附近之 TEM 影像圖 (b)對圖(a)進行全 | |
| | 光束電子繞射所得的 ED 圖;左半邊為利用 XRD 數據 | |
| | 轉換所得電子繞射圖 (c)奈米銀帶高倍率TEM影像 (d)對 | |
| | (c)中單一奈米銀帶進行電子繞射(箭頭所指部分)所得的ED | |
| | 圖;其zone axis=[111] | 12 |
| 圖十七 | 奈米銀帶樣品所做的 XRD 繞射圖,下表為由 XRD 數 | |
| | 據中利用公式求得奈米銀帶的晶格常數與JCPDS標準值之 | |
| | 比較。 | 13 |
| 圖十八 | 奈米銀帶產生途徑之示意圖。首先,AgNO3的Ag ⁺ 與CTAC | |
| | 的Cl ⁻ 在溶液中相遇而產生了AgCl的懸浮顆粒;接著藉由光 | |
| | 的能量,AgCl的懸浮顆粒被還原為懸浮的銀奈米顆粒,部 | |
| | 分隨機移動的奈米銀顆粒落到了銅網上;之後,藉由賈凡 | |
| | 尼電池的Cu-Ag制換反應在CTAC的輔助之下成長為奈米銀 | |
| | 带。 | 14 |